

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或遊說購入、購買或認購證券之要約，或邀請訂立協議進行上述任何事宜，亦無意招攬任何要約以購入、購買或認購任何證券。本公告並非在中國、香港及美國或其他地方銷售證券之要約。該等債券不可於香港或其他地方進行一般認購。

本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的要約或遊說。本公告所述該等債券並未亦不會根據證券法登記，且除非已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。該等債券不會於美國公開發售。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

建議發行債券

聯席牽頭經辦人



J.P.Morgan

建議發行債券

本公司建議僅向專業投資者進行債券的國際發售。債券在發售中將僅向機構投資者在美國根據規則144A發售及出售，而在美國境外則根據S規例發售及出售。

德意志銀行及J.P. Morgan為債券發行事宜的聯席牽頭經辦人。債券定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過聯席牽頭經辦人協調的累計投標方式釐定。於本公告日期，建議發行債券的本金額、利息及其他條款及條件有待釐定。於最終確定建議發行債券的條款後，預期本公司及聯席牽頭經辦人會訂立認購協議及與建議發行債券有關的其他輔助文據。

本公司擬將所得款項淨額用作(i)償還本公司債務；及(ii)擴大8吋及12吋製造設施產能相關之資本開支及一般公司用途。

在建議發行債券方面，本公司將向若干專業投資者提供有關本集團的若干公司及財務資料。該資料先前或未有必要公開。為了向股東及投資團體公平、有效和及時分發資料，有關資料摘錄隨附於本公告，及本公告將可在本公司網站(www.smics.com)查閱。

債券於新加坡證券交易所上市及報價已得到原則上同意。新加坡證券交易所並不就本公告中所作出的聲明或發表的意見是否正確一事上負上任何責任。債券原則上獲准於新加坡證券交易所上市及報價對本公司或債券的優點概無指示性。

因於本公告日期並無就建議發行債券訂立具有約束力的協議，建議發行債券未必會落實。完成建議發行債券須待若干條件達成後方可作實，包括但不限於全球市場狀況及投資者興趣。務請投資者及股東於買賣本公司證券時審慎行事。

本公司將於適當時候另行刊發有關建議發行債券的公告。

建議發行債券

本公司建議僅向專業投資者進行債券的國際發售。債券在發售中將僅向機構投資者在美國根據規則144A發售及出售，而在美國境外則根據S規例發售及出售。

德意志銀行及J.P. Morgan為債券發行事宜的聯席牽頭經辦人。債券定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過聯席牽頭經辦人協調的累計投標方式釐定。於本公告日期，建議發行債券的本金額、利息及其他條款及條件有待釐定。於最終確定建議發行債券的條款後，預期本公司及聯席牽頭經辦人會訂立認購協議及與建議發行債券有關的其他輔助文據。

債券並無且不會根據證券法登記註冊，且在若干例外情況的規限下，不得於美國境內提呈發售或出售。債券將根據規則144A(於美國境內)及S規例(於美國境外)向機構投資者提呈發售及出售。債券將於香港向專業投資者發行。債券不會於香港向公眾人士提呈發售或出售，亦不會向本公司任何關連人士配售。

在建議發行債券方面，本公司將向若干專業投資者提供有關本集團的若干公司及財務資料。該資料先前或未有必要公開。為了向股東及投資團體公平、有效和及時分發資料，有關資料摘錄隨附於本公告，及本公告將可在本公司網站(www.smics.com)查閱。

所得款項建議用途

本公司擬將所得款項淨額用作(i)償還本公司債務；及(ii)擴大8吋及12吋製造設施產能相關之資本開支及一般公司用途。

上市

債券於新加坡證券交易所上市及報價已得到原則上同意。新加坡證券交易所並不就本公告中所作出的聲明或發表的意見是否正確一事上負上任何責任。債券原則上獲准於新加坡證券交易所上市及報價對本公司或債券的優點概無指示性。

有關本公司的資料

本公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國規模最大、技術最先進的晶圓代工企業。本公司提供0.35微米到28納米的集成電路晶圓代工與技術服務。本公司總部位於中國上海，在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm超大規模晶圓廠。在北京建有一座300mm超大規模晶圓廠及另有一座擁有控股權的具備先進技術製程的300mm晶圓廠在開發中，在天津建有一座200mm晶圓廠，在深圳有一座200mm晶圓廠項目在開發中。本公司還在美國、歐洲、日本及台灣提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。

一般事項

因於本公告日期並無就建議發行債券訂立具有約束力的協議，建議發行債券未必會落實。完成建議發行債券須待若干條件達成後方可作實，包括但不限於全球市場狀況及投資者興趣。務請投資者及股東於買賣本公司證券時審慎行事。

本公司將於適當時候另行刊發有關建議發行債券的公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「美國預託證券股份」	本公司之美國預託證券股份，其每股相當於50股股份；
「董事會」	董事會；
「債券」	本公司建議發行的美元債券；
「本公司」	中芯國際集成電路製造有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板上市，其美國預託證券股份則於紐約證券交易所上市；
「關連人士」	具上市規則賦予的涵義；
「德意志銀行」	德意志銀行新加坡分行；
「董事」	本公司董事；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「香港」	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司；
「聯席經辦人」	德意志銀行及J.P. Morgan；
「J.P. Morgan」	J.P. Morgan Securities plc；
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣)；
「建議發行債券」	建議發行債券(如本公告所述)；
「S規例」	證券法項下 S 規例；
「規則144A」	證券法第144A條；
「證券法」	一九三三年美國證券法(經修訂)；
「新加坡證券交易所」	新加坡證券交易所有限公司；

「股份」	本公司股本中每股面值0.0004美元的股份；
「股東」	股份持有人；
「美國」	美利堅合眾國；
「美元」	美國法定貨幣美元；及
「%」	百分比。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
 首席執行官兼執行董事
邱慈雲

上海，二零一四年九月十七日

於本公告日期，董事分別為：

執行董事

張文義(董事長)
 邱慈雲(首席執行官)
 高永崗(首席財務官)

非執行董事

陳山枝(替任董事李永華)
 劉遵義(替任董事陳大同)
 周杰

獨立非執行董事

William Tudor Brown
 馬宏升(*Sean Maloney*)
 孟樸
 陳立武
 周一華

附錄

發售通函摘錄

本附錄所用若干釋義及慣用語

如本公告附錄所用者，對「我們」、「發行人」及「本公司」的提述均指於開曼群島註冊成立的有限公司中芯國際集成電路製造有限公司及其附屬公司(如文義所指)。

於本附錄，除非文義另有訂明或所指，以下詞彙具有所示涵義：

「燦芯」	指	燦芯半導體有限公司
「晶圓廠」	指	半導體製造工廠
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美國證交會」	指	美國證券及交易委員會
「中芯北京」	指	中芯國際集成電路製造(北京)有限公司
「中芯深圳」	指	中芯國際集成電路製造(深圳)有限公司
「中芯上海」	指	中芯國際集成電路製造(上海)有限公司
「中芯北方」	指	中芯北方集成電路製造(北京)有限公司
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「晶圓」	指	薄平的圓形矽片，是大多數集成電路的基礎

本公告本附錄內市場數據及若干行業預測及統計數字取自公開及私密資料來源，包括市場研究、公開資料及行業刊物。儘管我們相信本資料屬可靠來源，但其未經我們或我們的董事及顧問獨立核實，且我們或我們的董事及顧問並無對該資料的準確性或完整性發表任何聲明。有關資料可能與中國境內外所編纂的其他資料不符。此外，第三方資訊提供商可能從市場參與者取得資料，而該資料可能未經獨立核實。本公告本附錄概述了若干文件及其他資料，及投資者應參考該等文件以便更加完整地理解該等文件所討論內容。各位投資者於作出投資決定時務請自行查核有關我們的資料(包括所涉是非曲直及

風險)。於本公佈所附帶風險因素應與本公司的二零一三年表格20-F(為於二零一四年四月十四日呈交美國證交會的本公司年報)一併閱讀。

與我們的財務狀況及業務有關的風險因素

我們或不能實現或維持盈利水平，主要原因是固定成本可能增加及我們產品的平均售價下降所反映的市場競爭可能加劇。

我們的利潤於二零一三年共計174.5百萬美元及於二零一二年共計22.5百萬美元。然而，由於有關利潤的抵銷影響，我們於二零一三年年底仍然錄得累計虧損淨額1,693.9百萬美元。我們或不能實現或維持年度或季度盈利水平，主要原因是我們的業務特點是與先進技術設備採購有關的固定成本高企，因而導致折舊開支高企。由於我們裝配及提升額外晶圓廠和於現有晶圓廠擴充產能，我們將繼續產生資本開支及折舊開支。此可能導致固定成本增加及可能降低我們實現或維持盈利水平的機率。目前，如我們截至二零一四年六月三十日止六個月的未經審核中期報告所披露，二零一四年晶圓廠運作的計劃資本開支為約11億美元，較二零一三年表格20-F(我們於二零一四年四月十四日交予美國證交會存檔的年報(「二零一三年表格20-F」))所披露的8.8億美元有所增加。有關資本開支主要是以下各項支銷：(i)我們於北京的多數控股附屬公司中芯北方，該公司由我們出資55%及由中芯北方的其他股東出資45%；(ii)為我們的深圳8吋晶圓廠收購二手設備；(iii)產品組合變化，包括我們的上海12吋晶圓廠從40／45納米轉換為28納米；及(iv)我們的天津8吋晶圓廠產能從39仟片擴充到42仟片。此外，由於二零一四年非晶圓廠運作的資本開支主要用作建設僱員生活園區(作為我們僱員留才計劃的一部分)，我們亦預算約1.10億美元。

此外，我們正於相同技術環境下與若干其他晶圓廠及運作該等晶圓廠的競爭對手競爭，該等競爭對手經常使用價格作為取得業務的途徑，導致我們產品組合的平均售價下降，對我們實現或維持盈利水平的能力造成不利影響。

本公司的銷售依賴少數客戶，而對任何客戶的銷售額下降均會使經營業績受損。

本公司大部份業務依賴少數客戶支持。於截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，我們的五大客戶分別佔總銷售額的56.1%及52.3%。截至二零一四年六月三十日止六個月，我們的五大客戶佔我們總銷售額的51.0%。本公司預期，我們很大部份的銷售額仍會依賴數目有限的客戶。日後任何期間來自該等客戶的銷售額無論個別或合計均未必達到本公司預期或過往的水平。倘若該等客戶取消或減少訂單、對產品付運期作出重大改動或要求降低價格，則本公司的銷售額將大幅減少，而使本公司的業績受到不利影響。

我們維持一定水平的負債，可能對財務穩健性及經營業績有不利影響。

我們已產生及可能繼續產生負債，藉以為我們的部門及營運資金提供資金，此可能對財務穩健性及經營業績有不利影響。於二零一四年六月三十日，我們錄得總負債約11.5億美元。

我們的負債可能使我們更加承受若干與債務融資有關的風險，包括但不限於以下各項：

- 我們將需撥出部分現金流償付現有債務及利息，此將減少營運資金、資本開支、收購及其他一般企業要求所需要的現金流；
- 我們日後按優惠條款取得額外融資的能力可能受損；
- 我們利用重大新業務機會的能力可能有限；
- 倘市場或經營狀況惡化，我們將更加難於履行付款責任；及
- 倘我們未能償付負債，其會對我們的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響。

我們預期需要不斷取得其他專有技術的特許權，而我們須就此支付特許權費，亦可能會遞延我們產品的開發及市場推廣工作。

雖然我們繼續開發我們本身的技術並且為其爭取專利權保障，但我們預期繼續倚賴與第三方達成的特許權安排製造若干先進晶圓。於二零一四年六月三十日，我們已獲得全球4,233項專利權，其中60項屬於台灣、380項屬於美國、3,780項屬於中國及13項屬於其他司法權區。與之相比，我們相信競爭對手及其他同業已獲得不同司法權區多項涉及製造晶圓的更多項專利權。我們有限的專利權組合，日後可能對以交換特許權方式以有利的條款取得其他專有技術的特許權的能力有不利影響。特許權相關的費用可對本公司的財務狀況及經營業績有不利影響，亦會降低我們服務的競爭力。倘基於任何理由我們未能以可接受條款取得必需的技術特許權，則我們可能需要自行開發其他技術，可能成本高昂並延遲主要產品的市場推廣工作及付貨時間，因而損害我們的業務及經營業績。此外，我們未必可及時獨立開發客戶所需的技術，或者根本不能自行開發有關技術，於此情況下我們客戶可能向我們的競爭對手採購晶圓。

我們的北京大型晶圓廠房位於容易受到季節性沙塵暴影響的地區，於該等設施的生產工序可能會受到污染，因此我們須耗用額外資金以免該等廠房受沙塵影響，以致影響我們的業務、財務狀況及經營業績。

我們的北京廠房所在位置容易受到季節性沙塵暴的影響，或會有塵粒進入大樓並影響生產。儘管我們正在設置預防性過濾系統，但未必足以使廠房隔絕塵埃的污染。倘塵埃影響北京廠房的生產，則我們的品質控制會出現問題、在生產過程中有產品損耗，並且導致延遲交貨予客戶。此外，倘現時的預防措施不足，則我們或須動用額外資金進一步將廠房與塵埃隔絕。出現上述任何情況，均會對我們的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響。

有關財務狀況及經營業績之管理層討論與分析

以下討論與分析應與我們的年度合併財務報表、經選擇合併財務數據及中期簡明合併財務報表，且各自連同其隨附附註一併閱讀。

本節載有涉及風險及不明朗因素之前瞻性陳述。除歷史事實之陳述外，本節所載說明我們預期或預計將會或可能於未來發生的活動、事件或進展之所有陳述，均為前瞻性陳述。該等陳述乃基於我們根據經驗所作出的假設及分析，連同我們對歷史趨勢、目前狀況及預期未來進展的洞悉，以及我們認為在此等情況下屬合適的其他因素。

除非文義另有規定，本附錄內對「二零一一年」、「二零一二年」及「二零一三年」的提述分別指截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止財政年度。

概覽

我們是全球領先的半導體代工廠之一，且就收入及產能而言，為中國最大的代工廠。我們亦為中國技術最先進的代工廠，提供0.35微米至28納米集成電路代工及技術服務。

我們的業務主要位於中國。於二零一三年，我們實現總銷售額2,069百萬美元，而二零一二年則為1,701.6百萬美元。於二零一三年，我們錄得年度利潤174.5百萬美元及經營活動產生現金738.0百萬美元，而二零一二年年度利潤為22.5百萬美元及經營活動產生現金435.2百萬美元。於截至二零一四年六月三十日止六個月，我們的銷售額為962.4百萬美元，而於截至二零一三年六月三十日止六個月則為1,042.9百萬美元。於截至二零一四年六月三十日止六個月，我們錄得利潤76.1百萬美元及經營活動產生現金278.7百萬美元，而於截至二零一三年六月三十日止六個月的利潤及經營活動所得現金則分別為115.8百萬美元及263.0百萬美元。

影響我們的經營業績及財務狀況的主要因素討論如下。

影響本公司經營業績的因素

半導體行業的發展周期

半導體行業的發展周期短促，主要是由於使用半導體的產品市場需求週期所致。當該等市場出現波動時，半導體市場亦會隨之波動。由於半導體公司(包括代工廠)或需數年時間規劃及興建晶圓廠及其投產，故此在需求高企期間爭相對廠房及設備作出資本投資，結果對半導體市場波動更有推波助瀾的作用。在半導體市場需求增長不繼時，上述生產能力的提升導致半導體市場產能過剩，以往亦曾因此引致生產能力使用率嚴重不足，半導體價格大幅下跌。由於半導體行業屬於資本密集型且需在計劃擴充前撥資購置設備，故此半導體行業對需求下降的反應一般較慢。有關建議發行債券方面請參閱發售通函「風險因素 — 與我們的財務狀況及業務有關的風險」。

重大資本開支

半導體代工行業的特點是需要大量資本開支。由於本公司最近已興建及配備晶圓廠，並繼續建設及配備新的晶圓廠，故此上述特點尤其切合本公司的情況。於二零一一年、二零一二年及二零一三年，本公司興建及擴充生產能力所動用的資本開支分別為765百萬美元、499百萬美元及770百萬美元。本公司的生產機器及設備按其五至七年的估計可使用年期以直線法計算折舊。於二零一一年、二零一二年及二零一三年，本公司的折舊分別為518.8百萬美元、531.8百萬美元及501.9百萬美元。

半導體行業的另一特點為技術日新月異，加工技術及產品不斷推陳出新。因此，本公司的研發工作對整體業務成功十分重要。於二零一一年、二零一二年及二零一三年，本公司的研發開支分別為191.5百萬美元、193.6百萬美元及145.3百萬美元。於二零一一年、二零一二年及二零一三年的研發開支分別佔本公司於二零一一年、二零一二年及二零一三年銷售額的14.5%、11.4%及7.0%。我們的研發開支部分被相關政府撥款抵銷，並包括新晶圓設施提升產能的相關成本。

目前，我們預期二零一四年晶圓廠運作的資本支出將為約11億美元，可根據市場情況予調整，其較我們的二零一三年表格20-F所披露的880百萬美元有所增加。我們估計，該等資本支出將用於(i)我們於北京的多數控股附屬公司中芯北方，該公司由我們出資55%及由中芯北方的其他股東出資45%；(ii)為我們的深圳8吋晶圓廠收購二手設備；(iii)產品組合變化，包括我們的上海12吋晶圓廠從40／45納米轉換為28納米；及(iv)我們的天津8吋晶圓廠產能從39仟片擴充到42仟片。此外，由於二零一四年非晶圓廠運作的資本開支主要用作建設僱員生活園區(作為我們僱員留才計劃的一部分)，我們亦預算約1.10億美元。我們的實際開支可能因各種原因而與計劃的支出有所不同，包括我們的業務計劃、我們的加工技術、市況、設備價格或客戶要求變動。我們將注意全球經濟，半導體行業，我們的客戶需求及我們的經營現金流，並調整我們的資本支出計劃(如必要)。

擴充生產能力

本公司一直並計劃繼續透過內部擴充、合資企業及收購擴展本公司的生產能力。生產能力提升對本公司的經營業績有重大影響，令本公司可生產及銷售更多晶圓，增加銷售額，並可以收購成本及折舊開支的形式列作成本的組成部分。我們已擴大現有8吋晶圓產能，由二零一三年的每月126,000片晶圓增至二零一四年上半年的每月135,000片晶圓，及擴充上海的12吋晶圓廠的產能，由二零一三年的每月12,000片12吋晶圓增至二零一四年上半年的每月14,000片12吋晶圓。

定價

本公司的製造服務價格，乃根據技術的複雜程度、當時市況、訂單數量、生產周期、客戶與本公司建立的業務關係的密切程度及以往記錄，以及本公司生產能力使用率釐定，以每片晶圓或每件管芯作為定價單位。由於本公司大部份成本及開支為固定或半固定，

故此一直以來半導體晶圓的平均售價波動嚴重影響本公司的邊際利潤。本公司出廠的晶圓平均售價由二零一二年的每片767美元增加至二零一三年的每片804美元。

加工組合調整及技術轉移

由於以不同技術加工的晶圓價格有重大差異，故此本公司所生產的晶圓組合是影響本公司的銷售額及盈利能力的主要因素之一。晶圓價值主要根據製造晶圓所用加工技術的複雜程度而釐定。此外，功能層次較高及系統級別集成較多的裝置所需的生產工序較多，而售價一般亦會較高。

利用某種水平技術生產的晶圓價格一般會隨著有關加工技術周期而逐步下降。因此，本公司不斷開發及獲取更先進的加工技術，並促使客戶改用有關技術，以維持或提高本公司的邊際利潤。此技術轉移需要不斷投資研發及技術相關收購，而本公司或會就提升技術而投入大量資金。

產能利用率

由於本公司大部份銷售成本屬於固定或半固定性質，故此以最大或接近最大生產能力使用率運作對本公司的盈利能力有重大正面影響。倘本公司提高使用率，則本公司所製造的晶圓數量將會增加，結果使每片晶圓的平均固定成本下降。因此，本公司的生產能力使用率對邊際利潤有重大影響。本公司每個期間的產能利用率主要因所產生晶圓組合及客戶訂單波動而有所差異。本公司於二零一一年、二零一二年及二零一三年的產能利用率為68.9%、88.3%及90.7%。影響產能利用率的因素是整體行業狀況、客戶訂單數量、所生產晶圓的複雜程度與組合、機器故障及其他營運中斷(例如與擴充產能或搬遷設備有關的中斷)及我們有效管理生產設施及產品流的能力。

本公司乃根據設備製造商列明的每件設備生產能力評估釐定有關廠房的生產能力，並就不間斷試產時的實際產量、為準備生產及保養而預期出現的停工期、預期產品組合及其他因素作出調整。由於該等因素包括主觀元素，故此本公司計算產能利用率的準則未必與競爭對手相同。

成品率

每片晶圓的成品率指該晶圓有效管芯數目與該晶圓可生產的管芯最高數量的比率。本公司不斷升級所採用的加工技術。由於需要時間穩定、改良和測試新的加工技術，故此在各項技術轉移初期的成品率一般較採用當時既有技術的成品率為低，有時更是大幅偏低。本公司在達到客戶要求的基本成品率前，不會向該客戶付運晶圓。成品率一般會經本公司研發人員、工藝工程師和設備供應商的專業知識和合作而得到改善。

關鍵會計政策

我們根據國際財務報告準則編製我們的財務報表，其要求我們作出判斷、估計及假設。我們根據最新資料、我們自身的過往經驗及我們認為在此等情況下屬合理的各類其他假設對該等估計及假設進行定期評估。由於使用估計乃屬財務報告過程的重要部分，因此實際結果可能因我們的估計不同而與我們的預期有所不同。

倘一項會計政策需要基於對作出估計之時具有高度不確定性的事宜的假設作出會計估計，及倘可以合理使用的不同會計估計或可能合理定期出現的會計估計變動會對合併財務報表造成重大影響，則該項會計政策被視為重大。我們相信以下會計政策涉及較高程度的判斷及複雜性，並需要我們作出重大會計估計。閣下應將以下重大會計政策、判斷及估計的說明與有關建議發行債券之發售通函所載的合併財務報表及其他披露事項一併閱讀。

存貨

存貨按成本(加權平均)或可變現淨值(「**可變現淨值**」)列帳(以較低者為準)，可變現淨值指「日常業務過程中估計售價減完成的估計成本及對銷售而言屬必要的估計成本」。我們主要按最新發票價格及當前市況估計有關製成品及在製品的款項可收回情況。倘若存貨項目的可變現淨值釐定為低於其帳面值，我們將於銷售成本撇減帳面成本與可變現淨值之差額。

長期資產

當發生事件或情況有變，顯示資產或現金產生單位(「現金產生單位」)的帳面值或不能收回時，我們評估長期資產的減值。我們考慮決定進行減值檢討的因素包括但不限於業務線或產品線的表現顯著遜於預期、明顯不利行業或經濟趨勢，以及資產使用的重大改變或重大計劃改變。

減值分析乃就資產或現金產生單位的可識別獨立現金流量最低水平而進行。當資產或現金產生單位的帳面值超過其可收回金額，則存在減值，減值為資產或現金產生單位的公平價值減銷售成本以及其使用價值兩者之較高者。公平價值減銷售成本的計算基於按公平基準進行且具有約束力的銷售交易的可用數據(就類似資產或可觀察市價減出售該資產的增量成本而言)。使用價值的計算乃基於貼現現金流量模式。目前，我們未能估計減值虧損的金額或未來數年何時將錄得虧損。業務假設的任何潛在變動(例如銷售預測、售價、利用)可能對我們的收入淨額產生重大不利影響。

我們根據資產使用模式及產能主觀判斷與特定現金產生單位有關的獨立現金流量。於我們的營運中繼續使用的資產的可收回性乃根據現金產生單位帳面值與估計日後貼現現金流量總額的比較而計算。倘現金產生單位的帳面值不能透過相關貼現現金流量收回，則會基於可得之最佳資料(包括市價或貼現現金流量分析)透過比較現金產生單位帳面值與其可收回金額之間的差額，計量減值虧損。可收回金額對於貼現現金流量模式使用的貼現率以及預計未來流入現金及用作推算的增長率極其敏感。

為了維持於半導體行的技術競爭力，我們與第三方訂立技術轉讓及技術特許權安排，以提高我們的生產工序的技術。有關技術特許權的付款入帳為無形資產或遞延成本，並按資產的估計使用年期以直線法攤銷。我們例行檢討該等無形資產及遞延成本的尚餘估計使用年期，而當有事件或情況有變，顯示或不能收回無形資產及遞延成本的帳面值，我們亦會評估其減值情況。當該等資產的帳面值釐定為超過其可收回金額時，我們將減低該等資產，並於作出此項決定當年撇減其帳面值至可收回金額。

以股份為基礎的補償開支

根據我們的購股權計劃發行的購股權及股份，其於授出日期的公平價值利用柏力克-舒爾斯期權定價模式而估計。該模式的制定是用於估計並無歸屬限制及可全數轉讓交易購股權的公平價值。此外，期權定價模式要求輸入非常主觀假設的假設數據，包括購股權的預計年期、估計止贖比率及預計股價波幅。授出購股權的預計年期指授出購股權預計發行在外的時日。至於止贖比率，我們使用歷史數據運用定價公式估計購股權行使及僱員離職情況。我們亦根據歷史波幅釐定預期波幅。該等假設本質上並不確定。不同假設及判斷會影響我們對授出購股權的相關普通股的公平價值計算，而估值結果及以股份為基礎的補償金額亦因而不同。

稅項

作為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，我們毋須繳納開曼群島稅項。我們的其他附屬公司須遵守其各自司法權區的所得稅法，包括中國、日本、美國、台灣及歐洲。於回顧期內，我們的所得稅責任甚微。

複雜稅務法規的詮釋、稅法的變動以及未來應課稅收入的金額和時間均存在不明朗因素。鑒於國際業務關係範圍廣闊以及現有契約協議的長期性質及複雜程度，日後需就實際的經營成果與所作的假設或該等假設的未來變化之間產生的差異調整已入帳的稅務收入及開支。我們基於合理估計，就其經營所在各國稅務機關審計的可能結果設立撥備。該撥備的金額基於多項因素，如過往稅務審計經驗，以及應課稅實體與負責的稅務機關對稅務法規的不同詮釋。各種問題均可能出現該等詮釋差異，但取決於我們各公司註冊地的現行情況。

倘應課稅利潤可供扣減虧損，則會就未動用稅務虧損確認遞延稅項資產。釐定可予確認之遞延稅項資產數額時，管理層須根據未來應課稅利潤可能出現的時間及水平連同稅務規劃策略作出重大判斷。

於二零一二年及二零一三年十二月三十一日，有關未動用稅務虧損之遞延稅項資產分別0.4百萬美元及零於本公司財務狀況表確認。遞延稅項資產變現與否主要視乎未來有否足夠的利潤或應課稅臨時差額。倘若未來實際所得利潤少於預期，就可能產生大額遞延稅項資產撥回，並於撥回期間在損益表內確認。

公平價值計量及估值程序

就財務呈報而言，我們的若干資產及負債乃按公平價值計量。在估計資產或負債的公平價值時，我們盡可能使用可觀察市場數據。倘無可觀察市場數據，我們委聘第三方合資格估值師進行估值。我們使用估值技術(包括非按可觀察市場數據的輸入)以估計若干類型財務工具之公平價值。

貿易及其他應收款項減值

我們於各報告期末評估是否存在任何客觀證據表明貿易及其他應收款項出現減值。為確定是否存在減值的客觀證據，我們會考慮多項因素，如債務人無力清償債務或出現重大財政困難以及拖欠付款或付款出現重大延誤的可能。

當有減值虧損的客觀證據時，我們考慮對未來現金流量的估計。減值虧損的金額是按資產帳面值與根據財務資產原來實際利率(即起始確認時的實際利率)貼現估計未來現金流量(不包括未曾發生的未來信貸虧損)所得現值之間的差額計算。當實際未來現金流量少於預期時，則可能出現重大減值虧損。

近期會計公告

國際財務報告準則第9號金融工具

於二零零九年十一月頒佈之國際財務報告準則第9號引入有關財務資產的分類及計量之新規定。於二零一零年十月修訂之國際財務報告準則第9號包括有關財務負債的分類及計量以及終止確認之規定。國際財務報告準則第9號主要規定載列於下文。

所有屬於國際會計準則(「**國際會計準則**」)第39號「金融工具：確認及計量」範圍內的已確認財務資產其後按攤銷成本或公平價值計量，特別是就以業務模式持有以收取合約現金流為目的之債務投資，及純粹為支付本金及未償還本金之利息而擁有合約現金流之債務投資，則一般於其後會計期間結束時按攤銷成本計量。所有其他債務投資及股本投資於其後會計期間結束時按公平價值計量。此外，根據國際財務報告準則第9號，實體可作出不可撤回之選擇，於其他綜合收益中呈列股本投資(並非持作買賣)公平價值之其後變動，惟只有股息收入通常於損益中確認。

就指定為按公平價值透過損益計量之財務負債而言，國際財務報告準則第9號規定，該負債因其信貸風險變動而導致其公平價值變動，該變動金額於其他綜合收益中呈列，除非在其他綜合收益中確認負債之信貸風險變動影響會導致或擴大損益上之會計錯配。財務負債信貸風險之公平價值變動其後不會重新分類至損益。根據國際會計準則第39號，指定為按公平價值透過損益列帳之財務負債公平價值變動全部金額於損益中呈列。

我們預計，日後應用國際財務報告準則第9號對有關我們的財務資產的呈報金額可能有重大影響(例如，我們現時歸類為按成本值計量可供銷售投資的權益工具將須於隨後報告期間結束時按公平價值計量)。然而，直至完成詳細審閱前，難以合理估計國際財務報告準則第9號的影響。

國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第12號及國際會計準則第27號(修訂本)投資實體

國際財務報告準則第10號(修訂本)已界定投資實體並要求符合投資實體釋義之呈報實體不得綜合計入其附屬公司，反而須於其合併及獨立財務報表以公平價值計入損益計量其附屬公司。

為符合投資實體資格，呈報實體須：

- 自一名或多名投資者獲得資金，以向彼等提供專業投資管理服務；
- 向其投資者承諾其業務旨在投資基金，純粹為了從資本增值獲得回報、獲得投資收入或兩者兼而有之；及
- 按公平價值基準計量及評估其絕大部份投資之表現。

國際財務報告準則第12號及國際會計準則第27號已作出相應修改，以引入有關投資實體的新披露規定。

於二零一四年六月三十日，由於我們並非投資實體，故我們預期對投資實體的修訂將不會對我們的合併財務報表產生任何影響。

國際會計準則第32號(修訂本)抵銷財務資產及財務負債

國際會計準則第32號之修訂釐清有關抵銷財務資產及財務負債的規定。特別是，該等修訂釐清「目前有抵銷的合法強制執行權利」及「同時變現及清償」的涵義。

由於我們目前並無任何財務資產及財務負債符合抵銷之資格，故我們預期應用該等國際會計準則第32號之修訂不會對我們的合併財務報表造成重大影響。

國際會計準則第36號(修訂本)非財務資產之可收回金額披露

國際會計準則第36號的修訂剔除在相關現金生產單位(「現金產生單位」)並無減值或減值撥回的情況下，商譽或無確定可使用年期無形資產所屬的現金產生單位可收回金額披露的規定。此外，有關修訂規定，當資產或現金產生單位的可收回金額按其公平價值減出售成本釐定時，須對有關公平價值級別、主要假設及估值技術作額外披露。我們預期應用該等國際會計準則第36號之修訂不會對我們的合併財務報表造成重大影響。

國際會計準則第39號(修訂本)衍生工具更替及對沖會計法之延續

國際會計準則第39號(修訂本)放寬當衍生對沖工具在若干情況下更替時終止對沖會計法的規定。修訂本亦澄清，任何由更替所引起的衍生對沖工具公平價值變動應包括在對沖有效評估之內。由於我們目前並無任何須更替之衍生工具，故我們預期應用該等國際會計準則第39號之修訂不會對我們的合併財務報表造成任何影響。

國際財務報告詮釋委員會 — 詮釋(「詮釋第21號」)徵費

國際財務報告詮釋委員會 — 詮釋第21號「徵費」處理何時將支付徵費之負債確認的問題。該詮釋界定徵費釋義，並訂明產生有關負債之責任事件是指法律所指出觸發支付徵費的活動。該詮釋提供有關不同徵費安排應如何入賬的指引，特別是其澄清了經濟強制或以持續經營基準編製財務報表均不意味著一個實體目前負有支付徵費的責任且有關責任將會因為在未來期間經營而被觸發。

由於我們並無任何徵費安排，故我們預期應用該等國際財務報告詮釋委員會 — 詮釋第21號不會對本公司的合併財務報表造成影響。

中國政府的獎勵

下表簡要列出我們的中國附屬公司符合中國政府的集成電路生產企業(「集成電路生產企業」)資格而獲得的重大獎勵。根據集成電路政策，我們的上海、北京及天津附屬公司均符合集成電路生產企業的資格。根據該等政策，投資總額超過人民幣80億元(約1,095百萬美元)或集成電路線寬小於0.25微米的集成電路生產企業，可享受以下所列優惠。有關該等獎勵之更詳細討論，請參閱「中國法規」。

獎勵	中芯上海、中芯北京及中芯天津
企業所得稅優惠政策	經地方稅務局批准後五年全數豁免及之後五年稅項減半
關稅及進口增值稅 (「增值稅」)優惠政策	對其合資格零部件及原材料，按照免稅類別豁免關稅及進口增值稅

經營業績

下表載列我們於所示期間有關合併經營業績之概要。我們認為，經營業績的期間比較不應被作為未來表現之參考而加以倚賴。

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一二年	二零一三年	二零一三年	二零一四年
	(以千美元計值，每股盈利除外)				
	(未經審核)				
收入	1,319,466	1,701,598	2,068,964	1,042,911	962,427
銷售成本	(1,217,525)	(1,352,835)	(1,630,528)	(809,396)	(723,256)
毛利	101,941	348,763	438,436	233,515	239,171
研發開支	(191,473)	(193,569)	(145,314)	(61,494)	(81,733)
銷售及市場推廣開支	(32,559)	(31,485)	(35,738)	(18,029)	(18,726)
一般及行政開支	(57,435)	(107,313)	(138,167)	(76,839)	(58,721)
其他經營收入(開支)	(11,190)	19,117	67,870	53,300	7,786
經營利潤(虧損)	(190,716)	35,513	187,087	130,453	87,777
利息收入	4,724	5,390	5,888	2,288	4,859
財務費用	(21,903)	(39,460)	(34,392)	(19,930)	(12,861)
外匯收益或虧損	17,589	3,895	13,726	5,094	(14,454)
其他收益或虧損	6,709	6,398	4,010	(240)	10,711
應佔聯營公司利潤	4,479	1,703	2,278	1,223	1,451
除稅前利潤(虧損)	(179,118)	13,439	178,597	118,888	77,483
所得稅利益(開支)	(82,503)	9,102	(4,130)	(3,046)	(1,361)
年內／期內持續經營業務利潤(虧損)	(261,621)	22,541	174,467	115,842	76,122
已終止經營業務					
年內／期內已終止經營業務利潤	14,741	—	—	—	—
年內／期內利潤(虧損)	(246,880)	22,541	174,467	115,842	76,122
其他綜合收益					
可能隨後重新分類至損益的項目					
換算境外業務財務報表之匯兌差額	4,938	70	731	321	(1,953)
年內／期內綜合收益(開支)總額	(241,942)	22,611	175,198	116,163	74,169
以下各方應佔年內／期內利潤(虧損)：					
本公司擁有人	(246,817)	22,771	173,177	116,005	77,062
非控股權益	(63)	(230)	1,290	(163)	(940)
	(246,880)	22,541	174,467	115,842	76,122
以下各方應佔年內／期內綜合收益(開支)總額：					
本公司擁有人	(241,879)	22,841	173,908	116,326	75,109
非控股權益	(63)	(230)	1,290	(163)	(940)
	(241,942)	22,611	175,198	116,163	74,169
每股盈利(虧損)					
持續經營業務及已終止經營業務					
基本	\$ (0.01)	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00
攤薄	\$ (0.01)	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00
持續經營業務					
基本	\$ (0.01)	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00
攤薄	\$ (0.01)	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00

收入

我們的銷售額主要來自製造半導體。除了製造服務外，我們亦有小部份銷售額來自向第三方提供掩膜製作、晶圓探測及其他服務。

截至二零一四年六月三十日止六個月，無廠房半導體公司、集成裝置製造商以及系統及其他公司分別佔我們銷售額的87.0%、3.0%及10.0%。於二零一三年，無廠房半導體公司、集成裝置製造商以及系統及其他公司分別佔我們銷售額的87.7%、6.2%及6.1%。我們淨銷售額的一大部分來自相對較小數目的客戶。於二零一一年、二零一二年及二零一三年以及截至二零一四年六月三十日止六個月，我們五大客戶分別佔我們銷售額的約49.3%、56.0%、52.3%及51.0%。

銷售成本

我們的銷售成本主要包括：

- 折舊及攤銷；
- 間接生產成本，包括生產設備維修費用、間接物料(包括化學品、氣體及各類貴金屬與其他金屬)成本、公用設施費用和專利費；
- 直接物料成本，包括晶圓片成本；
- 工資，包括直接與生產活動有關的僱員的股份報酬開支；及
- 生產支援，包括設施、公用設施、質量監控、自動化系統及管理工作。

經營收入(開支)及收益(虧損)

研發開支

研發開支主要包括研發人員的薪金及福利、物料成本、本公司研發設備的折舊與維修費用、合約技術開發成本及與新廠房擴產有關的成本。研發開支部分獲有關政府資金所抵銷。

一般及行政開支

一般及行政開支主要包括行政支援、財務及人力資源人員的薪金與福利、僱員獎金、商業保險、專業服務的費用、城市維護建設稅開支、教育附加稅開支及壞賬開支。

銷售及市場推廣開支

銷售及市場推廣開支主要包括銷售和市場推廣人員的薪金與福利、客戶晶圓樣本成本、其他市場推廣獎勵和相關市場推廣開支。

其他經營收入(虧損)

其他經營收入(虧損)主要包括出售我們宿舍產生的收益或虧損、出售附屬公司產生的收益或虧損及長期資產減值虧損。

財務費用

我們的財務費用包括：

- 利息開支，已扣除資本化的部份和政府資金，主要來自我們的銀行貸款及未行使免息可換股債券按推定利率計算的利息；及
- 附屬公司優先股持有人權益增加。

其他收益或虧損

我們的其他收益或虧損主要包括：

- 我們學校、幼兒園及宿舍的收益及虧損；及
- 支付地方政府於二零一三年收取的土地閒置稅。

截至二零一三年及二零一四年六月三十日止六個月與截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度比較

截至二零一三年六月三十日止六個月與截至二零一四年六月三十日止六個月比較

收入

收入由截至二零一三年六月三十日止六個月的1,042.9百萬美元減少7.7%至截至二零一四年六月三十日止六個月的962.4百萬美元，主要因為自二零一四年第一季起並無來自武漢新芯集成電路製造有限公司(「**武漢新芯**」)的晶圓付運量。晶圓付運量的數量由截至二零一三年六月三十日止六個月的1,319,427片8吋等值晶圓減少6.7%至截至二零一四年六月三十日止六個月的1,230,385片8吋等值晶圓。我們付運晶圓的平均售價由截至二零一三年六月三十日止六個月的每片晶圓790美元減少至截至二零一四年六月三十日止六個月的每片晶圓782美元。

銷售成本及毛利

銷售成本由截至二零一三年六月三十日止六個月的809.4百萬美元減少10.6%至截至二零一四年六月三十日止六個月的723.3百萬美元，主要因為自二零一四年第一季度以來並無來自武漢新芯的晶圓付運量。

我們於截至二零一四年六月三十日止六個月的毛利為239.2百萬美元，而截至二零一三年六月三十日止六個月的毛利為233.5百萬美元，相當於增加2.4%。毛利率由截至二零一三年六月三十日止六個月的22.4%增加至截至二零一四年六月三十日止六個月的24.9%。毛利率增加主要因為(i)自二零一四年第一季度起並無來自武漢新芯的晶圓付運量(擁有較低毛利率)；及(ii)二零一四年上半年提升廠房效率。

期內經營利潤

經營利潤由截至二零一三年六月三十日止六個月的130.5百萬美元減少至截至二零一四年六月三十日止六個月的87.8百萬美元，主要原因是：(i)於二零一三年上半年出售上海部分宿舍產生的收益；及(ii)於二零一三年上半年出售本公司於中芯國際開發管理(武漢)有限公司(「**武漢開發公司**」)的全部所有權權益產生的收益，該公司主要從事建造、經營及管理我們於武漢的宿舍及學校。

研發開支由截至二零一三年六月三十日止六個月的61.5百萬美元增加32.9%至截至二零一四年六月三十日止六個月的81.7百萬美元，主要原因為研發活動增加。

一般及行政開支由截至二零一三年六月三十日止六個月的76.8百萬美元減少23.6%至截至二零一四年六月三十日止六個月的58.7百萬美元，主要原因是計提僱員花紅在二零一四年上半年減少。

截至二零一三年六月三十日止六個月的銷售及市場推廣開支為18.0百萬美元，而截至二零一四年六月三十日止六個月為18.7百萬美元。

截至二零一四年及二零一三年六月三十日止六個月的其他經營收入分別為7.8百萬美元及53.3百萬美元，有關減少乃因：(i)於二零一三年上半年出售我們於上海的部分宿舍產生收益；及(ii)於二零一三年上半年出售本公司於武漢開發公司的全部所有權權益產生收益，該公司主要從事建造、經營及管理我們位於武漢的宿舍及學校。

因此，我們經營利潤由截至二零一三年六月三十日止六個月的130.5百萬美元降至截至二零一四年六月三十日止六個月的87.8百萬美元。

期內利潤

基於上述因素，我們截至二零一三年六月三十日止六個月普通股持有人應佔利潤為115.8百萬美元，而截至二零一四年六月三十日止六個月則錄得76.1百萬美元。

截至二零一三年十二月三十一日止年度與截至二零一二年十二月三十一日止年度比較

收入

收入由二零一二年的1,701.6百萬美元增加21.6%至二零一三年的2,069.0百萬美元，主要是由於二零一三年上海12吋晶圓廠成功擴產及中國銷售額顯著上升所致。二零一三年，晶圓總付運量為2,574,119片8吋等值晶圓，較上一年增加16.1%。

我們付運晶圓的平均售價由二零一二年的每片晶圓767美元增加至二零一三年的804美元。40／45先進技術的晶圓佔收入百分比由二零一二年的1.1%上升至二零一三年的12.1%。

銷售成本及毛利

銷售成本由二零一二年的1,352.8百萬美元增至二零一三年的1,630.5百萬美元，主要由於較高生產成本的先進製程付運量增加。截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止年度，銷售成本總額之中分別有474.8百萬美元及403.0百萬美元為折舊及攤銷。

我們於二零一三年的毛利為438.4百萬美元，二零一二年則為348.8百萬美元，增幅達25.7%。二零一三年的毛利率為21.2%，而二零一二年為20.5%。毛利率上升的主要原因是二零一三年的整體產能利用率增加。

年內經營利潤

經營利潤由截至二零一二年十二月三十一日止年度的35.5百萬美元增至截至二零一三年十二月三十一日止年度的187.1百萬美元，主要原因是：(i)二零一三年出貨增加及產能利用率高；(ii)上海12吋晶圓廠成功擴產及削減每片晶圓的成本；(iii)提升廠房效率及節省成本；(iv)出售上海部分宿舍產生的收益及(v)出售我們於武漢開發公司(主要從事建造、經營及管理我們於武漢的宿舍及學校)的全部所有權權益產生的收益。

研發開支由截至二零一二年十二月三十一日止年度的193.6百萬美元減少24.9%至截至二零一三年十二月三十一日止年度的145.3百萬美元，主要由於上海12吋晶圓廠在二零一二年第四季開始大量生產，此後相關晶圓廠開支入帳為銷售成本。

一般及行政開支由截至二零一二年十二月三十一日止年度的107.3百萬美元增加28.8%至截至二零一三年十二月三十一日止年度的138.2百萬美元，主要由於二零一三年僱員花紅、城市維護建設稅開支及教育費附加的增加。

銷售及市場推廣開支由截至二零一二年十二月三十一日止年度的31.5百萬美元增加13.5%至截至二零一三年十二月三十一日止年度的35.7百萬美元，主要原因是僱員花紅增加。

截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止年度的其他經營收入分別為67.9百萬美元及19.1百萬美元，增幅是因為：(i)出售我們於上海的部分宿舍產生收益；(ii)出售我們於武漢開發公司的全部所有權權益產生收益(該公司主要從事建造、經營及管理我們位於武漢的宿舍及學校)；及(iii)因失去對燦芯半導體有限公司及其附屬公司的控制權而取消將其合併入帳而產生收益。

因此，我們截至二零一三年十二月三十一日止年度的經營利潤為187.1百萬美元，而截至二零一二年十二月三十一日止年度則為35.5百萬美元。

出售武漢開發公司

於二零一三年，我們與第三方買家訂立一項出售協議，出售我們於武漢開發公司的全部股權。該項出售於二零一三年五月二十三日完成，當日我們再無對武漢開發公司的控制權。有關代價為60.4百萬美元，且我們錄得收益28.3百萬美元，買方於二零一三年七月

二十六日悉數清償代價。武漢開發公司的主要業務為建造、經營及管理我們於武漢的宿舍及學校，並非我們的主要業務，因此，出售武漢開發公司並不納入終止經營業務。

取消將燦芯半導體有限公司及其附屬公司合併入帳

於二零一三年十二月三十日，燦芯(我們持有48.7%股權的公司)全體董事一致書面同意採納及批准燦芯的經修訂及重列組織章程細則、經修訂及重列投資者權利協議以及經修訂及重列表決協議。因此，我們失去燦芯的控制權，惟仍對其具相當影響力。此轉變並無產生現金代價。我們於燦芯的所有權權益列為於聯營公司的投資，確認因失去控制權而取消將燦芯合併入帳的收益為5.4百萬美元。燦芯主要從事設計服務，並非我們的主要業務，因此，因失去控制權而取消將燦芯合併入帳並不納入終止經營業務。

年內利潤

基於上述因素，我們二零一三年利潤為174.5百萬美元，而二零一二年則為22.5百萬美元。

截至二零一二年十二月三十一日止年度與截至二零一一年十二月三十一日止年度比較

收入

收入由二零一一年的1,319.5百萬美元增加29.0%至二零一二年的1,701.6百萬美元，主要是由於整體晶圓付運量上升所致。二零一二年，整體晶圓付運量為2,217,287片8吋等值晶圓，較上一年增加30.2%。

我們付運晶圓的平均售價由二零一一年的每片晶圓775美元減少至二零一二年的767美元。90納米及以下先進技術的晶圓所佔收入百分比在上述兩個年度自28.4%上升至41.7%。

銷售成本及毛利

銷售成本由二零一一年的1,217.5百萬美元增加11.1%至二零一二年的1,352.8百萬美元，主要由於整體晶圓付運量增加。截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度，銷售成本總額之中分別有403.0百萬美元及415.6百萬美元為折舊及攤銷。

我們於二零一二年的毛利為348.8百萬美元，二零一一年則為101.9百萬美元。二零一二年的毛利率為20.5%，而二零一一年為7.7%。毛利率上升的主要原因是產量增加，使收入上升及產能利用率改善。

年內經營利潤(虧損)

經營利潤(虧損)由截至二零一一年十二月三十一日止年度的虧損190.7百萬美元改善至截至二零一二年十二月三十一日止年度的利潤35.5百萬美元，主要由於(i)產量增加導致收入提高及產能利用率改善；(ii)於二零一二年出售我們於上海的部分宿舍產生收益；及(iii)長期資產於二零一一年的減值虧損。

研發開支由二零一一年的191.5百萬美元僅增加1.1%至二零一二年的193.6百萬美元。

一般及行政開支由二零一一年的57.4百萬美元增加86.8%至二零一二年的107.3百萬美元，主要由於二零一二年僱員花紅、城市維護建設稅開支及教育費附加的增加。另外，本公司在二零一一年藉訂立具合約約束力的協議解決與有關第三方債務人的若干糾紛，使本公司依法解除總額達19.0百萬美元的若干債務責任，所消除債項已分別入帳為一般及行政開支削減及其他收入。此外，收回壞帳開支6.4百萬美元及2.0百萬美元分別入帳為截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度的一般及行政開支削減。

銷售及市場推廣開支由二零一一年的32.6百萬美元減少3.4%至二零一二年的31.5百萬美元，乃由於更有效的市場推廣活動所致。

二零一二年的其他經營收入為19.1百萬美元，而我們於二零一一年錄得其他經營開支11.2百萬美元，該改善乃由於(i)於二零一二年出售我們於上海的部分宿舍而產生收益；及(ii)長期資產於二零一一年的減值虧損。

因此，我們於截至二零一二年十二月三十一日止年度錄得經營利潤35.5百萬美元，而截至二零一一年十二月三十一日止年度錄得經營虧損190.7百萬美元。

終止經營業務

二零一一年三月一日，我們出售於Semiconductor Manufacturing International (AT) Corporation(「AT」)所佔的主要所有權，而該實體亦不再合併入帳。因此，所有先前由AT發行的優先證券經已註銷。我們保留於AT的10%權益並將有關投資列作可供出售投資，因為於二零一一年十二月三十一日及二零一二年十二月三十一日我們不再對AT擁有控制性財務權益或有重大影響力。我們於簡明合併綜合收入表將AT的業績呈報為終止經營業務。我們就有關出售並無收取現金或其他代價。

我們就不再將AT合併入帳錄得17.1百萬美元的收益，相等於以下兩者之差：(i)(a)保留AT非控股投資的公平價值與(b)上述於AT非控股權益的帳面價值之和，及(ii)AT資產及負債的帳面價值。終止經營業務收入14.7百萬美元指AT由二零一一年一月一日至不再合併入帳期間的營運業績及取消AT合併入帳的收益。我們於二零一三年將我們於AT的餘下10%權益售出。

年內利潤(虧損)

基於上述因素，我們二零一二年利潤為22.5百萬美元，而二零一一年則有虧損246.9百萬美元。

流動資金及資本來源

我們預計我們的營運資金足夠應付我們的現時需求。我們將需要獲取大量資金為我們的未來資本開支及產能擴張需求提供資金，而這在迅速轉變的半導體製造行業中難以計劃。於二零一三年，我們就發行200百萬美元零息可換股債券訂立認購協議。中芯上海與五家銀行訂立本金總額為470百萬美元的新七年期貸款融資。中芯北京與中國進出口銀行訂立新美元貸款，本金額為60百萬美元的26個月營運資金貸款融資。於二零一四年五月，我們按比例發行大唐控股(香港)投資有限公司(「大唐」)及Country Hill Limited(「Country Hill」)有關二零一三年零息可換股債券86.8百萬美元，並於二零一四年六月發行約200百萬美元新股及通過發行額外可換股債券籌資95百萬美元。於二零一四年八月，大唐訂立協議認購金額為22.2百萬美元之額外優先債券及金額約為401.7百萬港元之優先股份，惟須取得股東於相關股東特別大會上之批准。亦於二零一四年八月，Country Hill訂立協議認購金額約為161.2百萬港元之優先股份，惟須取得股東於相關股東特別大會上之批准。我們預計二零一四年的業務營運所得現金流量及已發行新貸款及可換股債券的所得款項將足夠滿足我們二零一四年資本開支需求。如必要，我們亦將探索其他形式的外部融資。

下表載列我們於所示期間的現金流量表的簡明概要：

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一二年	二零一三年	二零一三年	二零一四年
	(千美元)			(未經審核)	
現金流量數據：					
年內／期內利潤(虧損)	(246,880)	22,541	174,467	115,842	76,122
利潤與經營現金流量淨額對帳的非現金調整：					
折舊及攤銷	551,857	566,899	546,910	271,464	275,334
經營活動所得現金淨額	379,368	435,166	738,016	262,998	278,674
對物業、廠房及設備的付款	(931,574)	(400,291)	(650,160)	(311,140)	(227,246)
投資活動所用現金淨額	(903,641)	(522,277)	(807,467)	(325,187)	(355,334)
融資活動所得現金淨額	268,855	184,101	173,458	(33,336)	188,832
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(255,418)	96,990	104,007	(95,525)	112,172

經營活動

於二零一四年六月三十日，我們的現金及現金等價為573.3百萬美元。該等現金及現金等價物以美元、日圓、歐元及人民幣形式持有。截至二零一四年六月三十日止六個月，我們的經營活動所得現金淨額為278.7百萬美元，主要由於純利76.1百萬美元、貿易及其他應收款項增加77.5百萬美元及折舊及攤銷加回275.3百萬美元。

於二零一三年十二月三十一日，我們有現金及現金等價物462.5百萬美元。該等現金及現金等價物以美元、日圓、歐元及人民幣形式持有。於二零一三年，我們的經營活動所得現金淨額為738.0百萬美元，主要由於純利174.5百萬美元、貿易及其他應收款項增加33.4百萬美元及折舊及攤銷加回546.9百萬美元。

於二零一二年十二月三十一日，我們有現金及現金等價物358.5百萬美元。該等現金及現金等價物以美元、日圓、歐元及人民幣形式持有。於二零一二年，我們的經營活動所得現金淨額為435.2百萬美元，主要由於純利22.5百萬美元、貿易及其他應收款項增加112.4百萬美元、存貨增加93.3百萬美元及折舊及攤銷加回566.9百萬美元。

於二零一一年十二月三十一日，我們擁有現金及現金等價物261.6百萬美元。該等現金及現金等價物以美元、日圓、歐元及人民幣形式持有。於二零一一年，我們經營活動所得現金淨額為379.4百萬美元，主要是由於淨虧損246.9百萬美元、貿易及其他應收款項減少73.1百萬美元、受限制現金增加60.2百萬美元、預付經營開支增加41.2百萬美元及加回折舊及攤銷費用551.9百萬美元所致。

投資活動

截至二零一四年六月三十日止六個月，我們投資活動所用現金淨額為355.3百萬美元，主要由於(i)購買上海晶圓廠及北京晶圓廠的廠房及設備，及(ii)按公平價值於損益列帳的短期投資所得款項與付款兩者的淨額。截至二零一三年六月三十日止六個月，投資活動所用現金淨額為325.2百萬美元，主要用於購買上海晶圓廠及北京晶圓廠的廠房及設備。

於二零一三年、二零一二年及二零一一年，我們投資活動所用現金淨額分別為807.5百萬美、522.3百萬美元及903.6百萬美元。該等款項主要用於購買我們於上海、北京及天津的晶圓廠的廠房及設備。

融資活動

截至二零一四年六月三十日止六個月，我們融資活動所得之現金淨額為188.8百萬美元，而截至二零一三年六月三十日止六個月，我們錄得融資活動所用現金淨額33.3百萬美元。彼等反映(i)新銀行借貸所得款項淨額及償還銀行借貸；及(ii)二零一四年上半年發行可換股債券所得款項淨額及發行新普通股所得款項淨額。

於二零一三年，我們的融資活動所得現金淨額為173.5百萬美元。這主要是來自借貸所得款項905.1百萬美元、償還借貸1,008.7百萬美元、發行可換股債券所得款項195.7百萬美元、非控股權益注資108.0百萬美元及償還承兌票據30.0百萬美元。

於二零一二年，我們的融資活動所得現金淨額為184.1百萬美元。這主要是來自借貸所得款項1,541.5百萬美元、償還借貸1,328.0百萬美元及償還承兌票據30.0百萬美元。

於二零一一年，我們融資活動所得現金淨額為268.9百萬美元。這主要是來自發行可換股優先股所得款項308.3百萬美元、借貸所得款項1,326.4百萬美元、償還借貸1,339.3百萬美元及償還承兌票據30.0百萬美元。

資本開支

截至二零一四年六月三十日止六個月，我們產生資本開支250.8百萬美元，而截至二零一三年六月三十日止六個月則為486.5百萬美元。我們主要透過經營及融資活動所產生的現金流量應付資本開支。於二零一一年、二零一二年及二零一三年，我們分別產生資本開支765百萬美元、499百萬美元及770百萬美元。我們目前預期於二零一四年我們代工業務的資本開支約為11億美元(可根據市場狀況予以調整)。我們估計，該等資本開支將用作(i) 我們擁有大部分權益的北京附屬公司中芯北方，其由我們及該實體的其他股東分別提供55%及45%的資金，(ii)為我們深圳8吋晶圓廠收購二手設備，(iii)產品組合改變，包括我們於上海的12吋晶圓廠由40／45納米轉為28納米，以及(iv)將天津8吋晶圓廠的產能由39仟片擴充至42仟片。此外，我們在二零一四年就非代工業務編列預算約110百萬美元的資本開支，主要用以建造僱員生活園區，此為我們留才計劃的一部分。我們計劃透過營運所得現金、銀行借貸、債務或股票發行及其他形式的融資撥付我們絕大部分的資本開支。

於二零一四年六月三十日，在建工程結餘約為497百萬美元，主要包括為進一步擴展於北京及上海12吋晶圓廠的產能，而分別購入130.8百萬美元及116.5百萬美元的生產設備；為進一步擴展於上海8吋晶圓廠的產能，而購入17.4百萬美元的生產設備；以及111.9百萬美元則與中芯深圳正在進行的8吋晶圓建造工程有關。由於市況變動及與有關方的磋商，我們於二零零八年展開的深圳項目進度遠較預期緩慢。我們將密切監察項目進度及評估完成項目的任何額外成本。此外，有120.4百萬美元與中芯國際其他附屬公司多項持續資本開支項目有關，預期該等項目將於二零一四年十二月三十一日前完成。

本公司向我們的中國附屬公司轉出任何資金(不無是股東貸款或是註冊資本增加)須登記或取得中國政府機構(包括相關外匯管理及／或相關審查批准機構)批准。此外，根據中國法律，我們的中國附屬公司不准相互直接貸款。因此，一旦本公司向我們的中國附屬公司匯出相關資金，則難以改變我們的資本開支計劃。該等對我們與我們的中國附屬公司之間自由資金流轉的限制，會限制我們及時作出行動回應不斷變化的市況並及時由一間中國附屬公司向另一間重新分配資金的能力。

承擔

於二零一四年六月三十日，我們有關北京、天津、上海及深圳設施建設責任的承擔為137.8百萬美元、有關主要為北京、天津、上海及深圳晶圓廠購買機器及設備的承擔為199.0百萬美元，以及購買無形資產的承擔為23.2百萬美元。於二零一三年十二月三十一日，我們有關旗下上海、北京及天津設施建設的設施建設承擔為114.9百萬美元。我們有關上海、北京、天津及芯電半導體(上海)有限公司(「**芯電**」)晶圓廠購買機器及設備的承擔為178.4百萬美元及10.1百萬美元購買知識產權。

銀行借貸

二零一二年美元貸款(中芯上海)

於二零一二年三月，中芯上海與國際及中國的銀行所組成銀團訂立本金總額為268百萬美元的貸款融資。此三年期銀行融資用於支持中芯上海8吋晶圓廠的營運資金。該融資以中芯上海8吋晶圓廠製造設備、中芯上海的樓宇及土地使用權作為抵押。於二零一四年六月三十日，中芯上海於此項貸款融資已提取268百萬美元，另償還134百萬美元。未償還結餘134百萬美元須於二零一五年三月前償還。截至二零一四年六月三十日止六個月，此項貸款融資的利率介乎3.64%至3.87%不等。

下列任何有關中芯上海的事項將於貸款協議期期間構成違約事件：

1. (短期貸款 + 長期債項即期部分 + 長期銀行貸款)除以總權益超過60%；或
2. (淨利潤 + 折舊 + 攤銷 + 所得稅撥備 + 財務費用)除以財務費用於二零一二年十二月三十一日前少於500%及於二零一三年一月一日後少於1000%；或
3. (總權益 — 收購無形淨資產)於二零一二年十二月三十一日前少於800百萬美元及於二零一三年一月一日後少於1,000百萬美元；或
4. 債務償債保障比率於貸款償還期內少於2.0倍。債務償債保障比率指過往四季EBITDA(淨利潤 + 折舊 + 攤銷 + 所得稅撥備 + 財務費用)除以同期的長期貸款定期還款及所有銀行借貸相關財務開支(包括租購、租賃及其他金錢借貸，惟不包括中／短期循環銀行貸款)。

於二零一四年六月三十日，中芯上海已遵守該等契諾。

二零一三年美元貸款(中芯上海)

於二零一三年八月，中芯上海與中國金融機構組成的銀團訂立本金總額為470百萬美元的貸款融資。此七年期銀行融資用於支持中芯上海12吋晶圓廠的擴張計劃。該融資以中芯上海12吋晶圓廠製造設備及樓宇作為抵押。於二零一四年六月三十日，中芯上海已提

取260百萬美元。未償還結餘260百萬美元須於二零一五年八月至二零一八年二月間償還。截至二零一四年六月三十日止六個月，此項貸款融資的利率介乎4.33%至4.89%不等。

下列任何有關中芯上海的事項將於貸款協議期期間構成違約事件：

1. (短期貸款 + 長期債項即期部分 + 長期銀行貸款)除以總權益超過70%；或
2. (淨利潤 + 折舊 + 攤銷 + 所得稅撥備 + 財務費用)除以財務費用於二零一三年少於550%及於二零一三年後少於1000%；或
3. (總權益 — 收購無形淨資產)於二零一三年少於800百萬美元及於二零一三年後少於1,000百萬美元。

於二零一四年六月三十日，中芯上海已遵守該等契諾。

二零一二年美元貸款(中芯北京)

於二零一二年三月，中芯北京與中國的金融機構所組成銀團訂立本金總額為600百萬美元的七年期北京美元銀團貸款。此七年期銀行融資用於支持中芯北京12吋晶圓廠的擴充產能。此項融資以中芯北京及中芯國際集成電路製造(天津)有限公司(「中芯天津」)擁有的晶圓廠製造設備及其全部股權作為抵押。於二零一三年九月二十六日，中芯北京及銀團將貸款融資金額修訂為260百萬美元。於二零一四年六月三十日，中芯北京已於此項貸款融資提取260百萬美元，並就此項貸款融資償還61.2百萬美元。未償還結餘198.8百萬美元須於二零一七年九月前償還。截至二零一四年六月三十日止六個月，此項貸款融資利率於介乎5.83%至5.88%不等。

下列任何有關中芯北京的事項將於貸款協議期期間構成違約事件：

1. 總負債除以總資產多於65%(總負債不包括股東貸款)；或
2. (淨利潤 + 折舊 + 攤銷 + 利息開支 + 融資所得現金流量)除以(本金 + 利息開支)少於100%。

於二零一四年六月三十日，中芯北京已遵守該等契諾。

二零一三年進出口美元貸款(中芯北京)

於二零一三年六月，中芯北京與中國進出口銀行訂立美元無抵押新貸款，為本金額60百萬美元的二十六個月營運資金貸款融資。該二十六個月銀行融資用作營運資金。於二零一四年六月三十日，中芯北京已提取該項貸款融資40百萬美元。本金額須於二零一五年八月償還。截至二零一四年六月三十日止六個月，此項貸款融資的利率介乎3.33%至3.35%不等。

二零一三年中投發展有限責任公司(「中投發展」)委託貸款(中芯北京)

於二零一三年六月，中芯北京經由中信銀行與中投發展訂立無抵押人民幣新貸款，為本金額人民幣70百萬元(約11.2百萬美元)的兩年期營運資金委託貸款融資。該兩年期委託貸款融資用作營運資金。於二零一四年六月三十日，中芯北京已提取該項貸款融資人民幣70百萬元(約11.2百萬美元)，並償還人民幣4.5百萬元(約0.7百萬美元)。未償還結餘人民幣65.5百萬元(約10.5百萬美元)須於二零一五年六月償還。截至二零一四年六月三十日止六個月，根據與中投發展及中芯協成投資(北京)有限責任公司訂立的住宅項目投資開發合作協議，該項貸款融資的利率為12%。

短期信貸協議

於二零一四年六月三十日，我們有21份短期信貸協議，以循環信貸方式合共提供最多約922.4百萬美元的信貸融資。截至二零一四年六月三十日，我們已根據此等信貸協議提取約152.4百萬美元。該等信貸協議的未償還借貸為無抵押，惟20.0百萬美元以定期存款18.8百萬美元作抵押。截至二零一四年六月三十日止六個月，此項貸款融資的利率介乎1.98%至3.78%不等。

於二零一二年五月，中芯上海與國家開發銀行訂立總額為人民幣50億元的四年期戰略性框架信貸融資。二零一三年美元貸款(中芯上海)構成戰略性框架信貸融資的一部分。

見下文「有關市場風險的定量及定性披露」關於與市價(包括外幣匯率及金融工具利率)不利變動有關之虧損風險。

研發、專利及牌照

我們的研發活動主要方向為發展及實施新的加工技術。於二零一一年、二零一二年及二零一三年，我們分別耗資191.5百萬美元、193.6百萬美元及145.3百萬美元於研發開支上，而截至二零一三年及二零一四年六月三十日止六個月則分別為61.5百萬美元及81.7百萬美元，分別佔各自期間我們銷售額之14.5%、11.4%、7.0%、5.9%及8.5%。於二零一一年、二零一二年及二零一三年以及截至二零一三年及二零一四年六月三十日止六個月，我們的研發費用部份被相關政府補助42.6百萬美元、31.0百萬美元、26.9百萬美元、13.6百萬美元及19.3百萬美元抵銷，並計入與新品圓設施提產相關之成本。

於二零一四年六月三十日，我們在全球範圍內獲授4,233項專利，其中60項屬台灣專利、380項屬美國專利、3,780項屬中國專利及13項其他司法權區專利。

資產負債表外安排

我們並無訂立任何資產負債表外之交易。

合約承擔

下表載列按合併基準計，根據我們的現有合約安排，我們於二零一四年六月三十日之未來現金付款承擔：

	按到期付款計 (合併，千美元)			
	總計	少於1年	1-2年	2-5年
合約承擔				
短期借貸	152,416	152,416	—	—
無抵押長期貸款	50,533	10,533	40,000	—
有抵押長期貸款	592,840	202,320	141,020	249,500
可換股債券	352,317	—	—	352,317
購買承擔 ⁽¹⁾	360,034	360,034	—	—
總合約承擔	1,508,140	725,303	181,020	601,817

附註：

(1) 建設或購買半導體設備及其他物業或服務承擔。

有關市場風險的定量及定性披露

市場風險為與市價(包括外幣匯率及金融工具利率)不利變動有關之虧損風險。我們於一般業務過程中面臨該等風險。我們所面臨的該等風險主要源自利率及外幣匯率變動。為降低該等風險，我們使用即期、遠期及衍生金融工具。

外匯匯率波動風險

我們的收入、開支及資本購買活動主要以美元交易。然而，由於我們的業務包括於美國以外的製造、銷售活動及資本購買，故我們亦以其他貨幣訂立交易。我們主要面對歐元、日圓及人民幣匯率變動的風險。

為盡量降低該等風險，我們購買一般為期少於十二個月的遠期外匯合約，以避免匯率波動對外幣計值交易活動造成不利影響。該等遠期外匯合約主要以人民幣、日圓或歐元計值，且不符合對沖會計法。於二零一四年六月三十日，我們並無尚未償還之外幣遠期兌換合約。

我們並無就投機目的訂立外幣兌換合約。有關建議發行債券方面請參閱發售通函「風險因素 — 有關在中國經營的風險 — 人民幣貶值或升值或人民幣的兌換限制或會不利於我們的業務及經營業績」及「風險因素 — 有關債券的風險 — 債券持有人或會面臨美元及其他貨幣之間匯率變動而出現的風險」。

利率風險

我們的利率風險主要來自本公司的長期債項承擔(一般用作應付資本開支及營運資金需求)。下表載列於二零一三年十二月三十一日我們尚未償還債務承擔的每年到期本金額及到期年份的相關加權平均隱含遠期利率。我們的長期債務承擔的利率全屬浮動。我們的美元貸款利率與倫敦銀行同業拆息率掛鉤。我們的人民幣計值貸款與中國人民銀行人民幣利率掛鉤。因此，我們的貸款的利率受相關掛鉤利率出現波動。

	二零一四年	二零一五年
	(預測)	
	(千美元，百分比除外)	
美元計值		
平均結餘	853,889	672,221
平均利率	4.59%	4.66%
人民幣計值		
平均結餘	10,795	5,264
平均利率	12%	12%
加權平均遠期利率	4.68%	4.72%